



半导体行业：看好 IC 设计板 块底部复苏机会



三季度总结

半导体设计板块三季度业绩承压明显，行业最差时候即将过去。

三季度半导体行业实现营收合计 1141 亿元，同比增长 5.90%，环比增长 0.16%，实现归母净利润合计 104 亿元，同比 39.02%，环比下滑 42.76%。细分板块中，IC 设计板块三季度营收、归母净利润下滑幅度居前，业绩承压明显，特别是消费性电子领域收入占比较高的公司。

IC 制造板块景气度传导相对滞后，三季度营收依然呈现增长趋势，但是业绩环比出现下滑。受下游客户扩产和国产化驱动，设备及零部件板块三季度营收、净利润依然实现较高增长。EDA 板块由于收入规模相对较小，在国产化替代驱动下三季度营收和净利润均实现较好增长。

行业库存

部分领域 IC 厂商主动降库存初显成效，行业库存成改善趋势。

从 IC 设计公司库存情况看，受下游需求疲弱影响，IC 设计公司在二三季度已经开始进行主动降库存，从三季度的存货情况看，已有部分公司三季度库存环比出现改善趋势。我们认为，伴随着设计公司的主动降库存，行业库存的去化有望在明年上半年迎来明显成效。

投资建议

我们认为，IC 设计板块从年初以来股价调整幅度较大，当前估值已经

处于历史低位，尽管当前 IC 设计下游需求仍不明朗，但部分 IC 厂商的库存去化已初显成效，行业库存预计将成改善趋势。今年以来，受 IC 库存水位较高，以及智能手机等消费性电子产品出货量下滑幅度较大等因素影响，IC 设计板块业绩承压明显。伴随着库存的去化，以及后续需求的回暖，板块业绩有望底部改善。标的方面，射频建议关注：卓胜微、唯捷创新；MCU、处理器建议关注：兆易创新、国芯科技、中颖电子、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技；模拟 IC 建议关注：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、艾为电子、芯朋微、晶丰明源等；传感器建议关注：韦尔股份、思特微；存储建议关注：北京君正、兆易创新、聚辰股份、普冉股份。

风险提示

半导体行业景气度持续下行；汽车电动化、智能化渗透不及预期；疫情给供应链造成的不确定性

关键词：疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48942

